

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2004年12月23日 (23.12.2004)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2004/111148 A1

- (51) 国際特許分類: C09J 7/00, 7/02, H01L 21/52, 21/301 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/008472
- (22) 国際出願日: 2004年6月10日 (10.06.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2003-164802 2003年6月10日 (10.06.2003) JP  
特願2003-166187 2003年6月11日 (11.06.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 増子 崇 (MASUKO, Takashi) [JP/JP]. 大久保 恵介 (OOKUBO, Keisuke) [JP/JP]. 畠山 恵一 (HATAKEYAMA, Keiichi) [JP/JP]. 湯佐 正己 (YUSA, Masami) [JP/JP].
- (74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目2番3号 虎ノ門第一ビル 9階 Tokyo (JP).
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: FILM-LIKE ADHESIVE, PROCESS FOR PRODUCING THE SAME, ADHESIVE SHEET AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: フィルム状接着剤、及びその製造方法、並びに接着シート及び半導体装置

(57) Abstract: A die bonding film-like adhesive capable of being laminated on the rear surface of a wafer at a temperature lower than the softening point of a protective tape for an extremely thin wafer or a dicing tape being pasted while reducing thermal stress, e.g. warp, of the wafer and simplifying production process of a semiconductor device and exhibiting excellent heat resistance and reliability of moisture resistance; an adhesive sheet being produced by pasting the film-like adhesive and the dicing tape; and a semiconductor device.

(57) 要約: 本発明は、極薄ウェハの保護テープ、又は貼り合わせるダイシングテープの軟化温度よりも低い温度でウェハ裏面にラミネートでき、かつウェハの反り等の熱応力を低減でき、半導体装置の製造工程を簡略化でき、さらに耐熱性及び耐湿信頼性に優れるダイ接着用フィルム状接着剤、当該フィルム状接着剤とダイシングテープを貼り合わせた接着シートならびに半導体装置を提供することを目的とする。

WO 2004/111148 A1